Produktdatenblatt Eigenschaften

BMEH582040

Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 2040 Level 2 DIO + RIO, 8 MB, 61 Eth-Geräte, 8 lokale und 8 Remote-E/A-Racks





Hauptmerkmale

Baureihe	Modicon M580
Produkt- oder Komponententyp	Redundante Prozessormodule

Zusatzmerkmale

Zusatzmerkmate	
Anzahl von Racks	1
Anwendungspezifischer E/A	Zähler Genaue Zeitstempelung Serielle Schnittstelle HART Motion Control SSI-Encoder
Prüfungen	Prozesssteuerung
Steuerkanäle	Programmierbare Regelkreise
Integrierte Verbindungsart	1 Ethernet TCP/IP für Service-Port 2 Ethernet TCP/IP für Gerätenetzwerk USB Typ Mini-B 1 Ethernet für HSBY-Port
Anzahl entfernter E/A-Stationen	8 - 2 Einbaugehäuse pro X80-Remote-Station
Anzahl verteilter Geräte	64
Kapazität des Kommunikationsbaustein-Prozessors	2 Ethernet-Kommunikationsmodul 8 AS-Interface-Modul
Kommunikationsdienst	DIO-Scanner RIO-Scanner
Speicherbeschreibung	Erweiterbar Flash, 4 GB für Datenspeicherung Integriert RAM, 10 KB für Systemspeicher Integriert RAM, 8 MB für Programm Integriert RAM, 768 kB für Daten
Anwendungsstruktur	1 periodische Fast Task 1 zyklisch/periodische Master Task
Cybersicherheit	Achilles-zertifiziert DoS-Abwehr IPSec SNMP-Logging Syslog-Protokollunterstützung Transport-Layer-Security Autit Trail (logging) Integrierte Firewall Firmware-Signatur Passwortschutz Härtung Sichere Kommunikation (HTTPS) Sicherheitsprotokoll
Anzahl der Anweisungen pro ms	7,5 Kinst/ms 65% boolesch + 35% fest-arithmetisch 10 Kinst/ms 100 % boolesch

Stromaufnahme	270 mA bei 24 V DC
MTBF Zuverlässigkeit	650000 H
Beschriftung	CE

Montage

Vibrationsfestigkeit	3 gn
Stoßfestigkeit	30 gn
Umgebungstemperatur bei Betrieb	060 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-4085 °C
Betriebshöhe	0 - 2.000 m 2000 - 5000 m mit Leistungsminderungsfaktor
Relative Luftfeuchtigkeit	595 % bei 55 °C ohne Kondensation
Schutzart (IP)	IP20
Richtlinien	2014/35/EU - Niederspannungsrichtlinie 2014/30/EU - elektromagnetische Verträglichkeit
Versorgung	Interne Stromversorgung über Modulträger
LED-Statusanzeige	1 LED (grün) Prozessor in Betrieb (RUN) 1 LED (rot) Prozessor- oder Systemfehler (ERR) 1 LED (rot) I/O Modulfehler (I/O) 1 LED (grün) Downloadvorgang aktiv (DL) 1 LED (rot) Speicherkarten- oder CPU-Flash-Fehler (BACKUP) 1 LED (grün/rot) ETH MS (Konfigurationsstatus Ethernet-Schnittstellen) 1 LED (grün/rot) Eth NS (Ethernet-Netzwerkstatus) 1 LED (grün) Peer-Prozessor in Betrieb (REMOTE RUN) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis A (A) 1 LED (grün) Prozessor-ID Satz bis B (B) 1 LED (grün) Prozessor primär (PRIM) 1 LED (grün) Prozessor Standby (STBY) 1 LED (grün) E/A-Werte durch Nutzer überschrieben (FORCED IO) 1 LED (grün) Hot-Standby-Verbindungsstatus (HSBY Diag)
Produktgewicht	0,849 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE	
VPE 1 Menge	1	
VPE 1 Höhe	8,800 cm	
VPE 1 Breite	17,800 cm	
VPE 1 Länge	25,000 cm	
VPE 1 Gewicht	883,000 g	
VPE 2 Art	S03	
VPE 2 Menge	6	
VPE 2 Höhe	30,000 cm	
VPE 2 Breite	30,000 cm	
VPE 2 Länge	40,000 cm	
VPE 2 Gewicht	5,795 kg	

Nachhaltigkeit

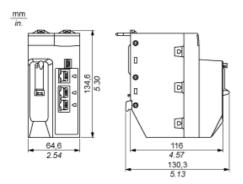
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	₫ Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

Garantie 18 Monate

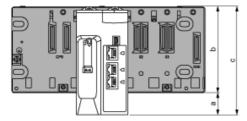
Produktdatenblatt Maßzeichnungen

BMEH582040

Nur CPU-Module

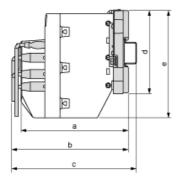


Auf Racks montierte Module



- a: Zusätzlicher Abstand unter dem Rack zur Berücksichtigung der Höhe der CPU. X Bus-Rack: Der Abstand beträgt 30,9 mm (1.217 in.)Ethernet-Rack: Der Abstand beträgt 29,49 mm (1.161 in.)
- b: Die Höhe des Racks. Für ein X Bus-Rack beträgt die Höhe 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack beträgt die Höhe 105,11 mm (4.138 in.).
- c: Die Höhe des lokalen Hauptracks, 134,6 mm (5.299 in.)

In ein Gehäuse montierte Module und Kabel



- a: Gehäusetiefe: 135 mm (5.315 in.)
- b: Tiefe Verdrahtung + Modul: > 146 mm (5.748 in.)
- c: Verdrahtung + Modul + DIN-Schienentiefe: > 156 mm (6.142 in.)
- d: Rackhöhe: X Bus-Rack 103,7 mm (4.083 in.); für ein Ethernet-Rack, 105,11 mm (4.138 in.)
- e: Modulhöhe: 134,6 mm (5.299 in.)